

Job Detail

Company Code:e6110 Job Code:20231106-233-01-002

Manager Level

Position Title	【半導体デバイス開発エンジニア】早稲田大学 研究シーズ発のスタートアップ
Recruiter Company	株式会社 リクルート (リクルートエージェント / Recruit Agent)
Company Name	(株)Power Diamond Systems
Activated / Updated	2024-05-07 / 2024-05-08
Job Type	Electronics (Appliance/Semiconductor) - Control - Programmer
Industry	Electronics, Components, and Semiconductor Manufacturing
Location	Asia Japan Tokyo
Job Description	<p>世界トップクラスのデータを出しているダイヤモンド半導体デバイス開発を主導いただきます。半導体デバイス単体の開発だけでなく、パワーアンプの設計等アプリケーション側の検討もさせていただきます。</p> <p><このポジションの魅力></p> <ul style="list-style-type: none">■早稲田大学が保有する半導体プロセス設備を最大限活用し大きな裁量権を持ち、世界最先端のダイヤモンド半導体デバイスの研究開発に没頭できます。■22年8月創業で未だ5名に満たない人員のため、半導体研究開発の経験を活かしながら、スタートアップの創業期でしか味わえないゼロイチで事業を作り上げていく貴重な経験を積むことができます。
Company Info	<p>ダイヤモンド半導体デバイスの研究開発</p> <p>従業員数 4名</p>
Qualifications	<p>【必須】</p> <ul style="list-style-type: none">■半導体やMEMS等の微細加工プロセスを伴うデバイスの開発経験■英語の論文(読解)への理解 <p>【歓迎】</p> <ul style="list-style-type: none">■化合物デバイス開発経験 (デバイスの設計・評価・回路設計・マスク設計等)■英語の論文(記述)スキル保有者 <p>【当社のビジョン】-究極の半導体材料ダイヤモンド"とともに一歩先の未来へ ? Diamond Opens The Future Electronics?"</p>
English Level	Business Conversation Level (TOEIC 735-860)
Japanese Level	Fluent(JLPT Level 1 or N1)
Salary	JPY - Japanese Yen JPY 5000K - JPY 7000K
Holiday Description	年間休日 110日
Job Contract Period	正社員